

安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司在徽商银行铜陵北京路支行申请授信人民币 3,000 万元以及中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信人民币 1,500 万元提供担保。截至目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为 9,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保总额：9,800 万元（不含本次担保）
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）将为全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供最高额为人民币 3,000 担保；在中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行申请的借款提供最高额为人民币 1,500 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

（二）担保履行的内部程序

2024年3月16日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供总额度不超过人民币20,000万元的综合授信担保，以用于各子公司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过17,000万元担保额度（以上详见公司2024年3月19日在上海证券交易所网站以及公司指定媒体披露的相关公告）

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
铜峰电子	铜峰世贸	100%	62.55%	9,000万元	4,500万元	2.63%	三年	否	否

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340700674235201N
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、法定代表人：鲍俊华
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2008年04月29日
- 7、经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）

8、住所：安徽省铜陵市翠湖三路西段 399 号

9、与公司的关系：铜峰世贸是公司全资子公司，公司拥有该公司 100%股权

10、被担保人铜峰世贸主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总计	21,577.17	19,653.27
负债合计	13,951.16	12,292.70
净资产	7,626.00	7,360.56
财务指标	2023 年 1-12 月	2024 年 1-6 月
营业收入	25,089.83	15,160.48
净利润	144.79	-267.76

三、担保协议的主要内容

1、保证人名称：安徽铜峰电子股份有限公司

2、债权人名称：徽商银行铜陵北京路支行；中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行

3、债务人名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：三年

6、担保金额：3,000 万元人民币；1,500 万元人民币

7、保证范围：包括本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足子公司的生产经营及补充流动资金，符合公司整体利益及发展战略，且担保对象为公司全资子公司，相关担保风险可以控制。

五、董事会意见

董事会认为：全资子公司铜峰世贸目前主要负责公司进出口业务，代理公司生产所需原材料、设备配件的进口以及产品的出口业务。本次为铜峰世贸提供担

保，将主要用于满足该公司在代理公司相关进出口业务中对资金需求，以保障公司生产经营的需要，有利于公司生产经营的平稳运行。铜峰世贸为公司的全资子公司，相关担保风险可以控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 9,800 万元人民币（不含本次担保），占公司 2023 年度经审计净资产的 5.74%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日